

RJ45C5 S1D 2.7N4N RL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Das Produktsortiment umfasst folgende Ausführungen:

- 90°, liegend (horizontal) und 180°, stehend (vertikal)
- Rasthaken oben und unten (latch up / latch down)
- THT-, THR- oder SMT-Lötverfahren
- Vielzahl verschiedener Bauformen auch mit integrierten LED's und Schirm-Kontaktfahnen
- Performance Kategorie von Cat.3 bis Cat.6
- Ausführung verpackt im Tray (TY) oder auf Rolle (Tape-on-Reel, RL)
- Kompatibel mit modularem RJ45 Stecker gemäß ANSI / TIA-1096-A und IEC 60603
- Spannungsfestigkeit $\geq 1500\text{V AC RMS}$ (2250V AC Scheitelwert) gemäß IEEE 802.3
- Spannungsfestigkeit $\geq 1500\text{V AC}$ (Scheitelwert) oder $\geq 1500\text{V DC}$ gemäß IEC 60603

Eigenschaften und Vorteile:

- Erweiterter Temperaturbereich von -40°C bis $+85^\circ\text{C}$, für maximale Leistungsfähigkeit
- Verstärkte Goldschicht ($30\mu\text{m}$) für verbesserten Korrosionsschutz
- Mindestens 0,3mm Stand-off gewährleistet ein perfektes Lötergebnis

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Leiterplattensteckverbinder, RJ45 Buchsen, Cat. 5, SMD-Lötanschluss, 90°, Riegel-Option: unten, Schirm tabs: keine, $30\ldots 80\mu\text{m Ni} / \geq 30\mu\text{m Au}$, LED: Nein, Polzahl: 8, Tape
Best.-Nr.	1433890000
Typ	RJ45C5 S1D 2.7N4N RL
GTIN (EAN)	4050118238471
VPE	260 Stück
Verpackung	Tape

RJ45C5 S1D 2.7N4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	18,7 mm	Tiefe (inch)	0,736 inch
Höhe	16,88 mm	Höhe (inch)	0,665 inch
Höhe niedrigstbauend	11,8 mm	Breite	18,5 mm
Breite (inch)	0,728 inch	Nettogewicht	0,007 g

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand	≥ 500 MΩ	Nennspannung	125 V
Nennstrom	1,5 A	PoE / PoE+	gemäß IEEE 802.3at
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt	1000 V DC	Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm	1500 V DC

Normen

Steckverbinder Norm	IEC 60603-7-51
---------------------	----------------

Systemkennwerte

Abgangswinkel	90°	Anschlussart	SMD-Lötanschluss
Anzahl Lötstifte pro Pol	1	Beschaltung	8-adrig
Kategorie	Cat. 5	Koplanarität	100 µm
LED	Nein	Leistungs-Kategorie	Cat. 5
Lötstift-Abmessungen	oktogonal	Lötstiftlänge (l)	3,5 mm
Lötstiftposition-Toleranz	± 0,1 mm	Lötverfahren	Reflow-Löten, Handlöten
Montage auf der Leiterplatte	SMD-Lötanschluss	Polzahl	8
Produktfamilie	OMINMATE Data – Modulare RJ45-Buchse	Raster in Zoll (P)	0,05 "
Raster in mm (P)	1,27 mm	Riegel-Option	unten
Schirm tabs	keine	Schirmmaterial	Kupferlegierung
Schirmoberfläche	vernickelt	Schirmung	Ja
Schutzart	IP20	Steckzyklen	750

Werkstoffdaten

Isolierstoff	PA 9T	Farbe	schwarz
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 9011	Isolierstoffgruppe	II
Kriechstromfestigkeit (CTI)	≥ 500	Isolationswiderstand	≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Kontaktbasismaterial	Phosphor-Bronze	Kontaktmaterial	Cu-leg
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel	Schichtaufbau - Steckkontakt	30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au
Lagertemperatur, min.	-40 °C	Lagertemperatur, max.	85 °C
Betriebstemperatur, min.	-40 °C	Betriebstemperatur, max.	85 °C

Verpackungen

Verpackung	Tape	VPE Länge	355 mm
VPE Breite	346 mm	VPE Höhe	131 mm
Tape-Spulendurchmesser Ø (A)	330 mm	Oberflächenwiderstand	Rs = 10 ⁹ - 10 ¹² Ω

RJ45C5 S1D 2.7N4N RL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument

[Certificate of Compliance](#)

Engineering-Daten

[CAD data – STEP](#)

Anwenderdokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschüren

[MB FREECONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

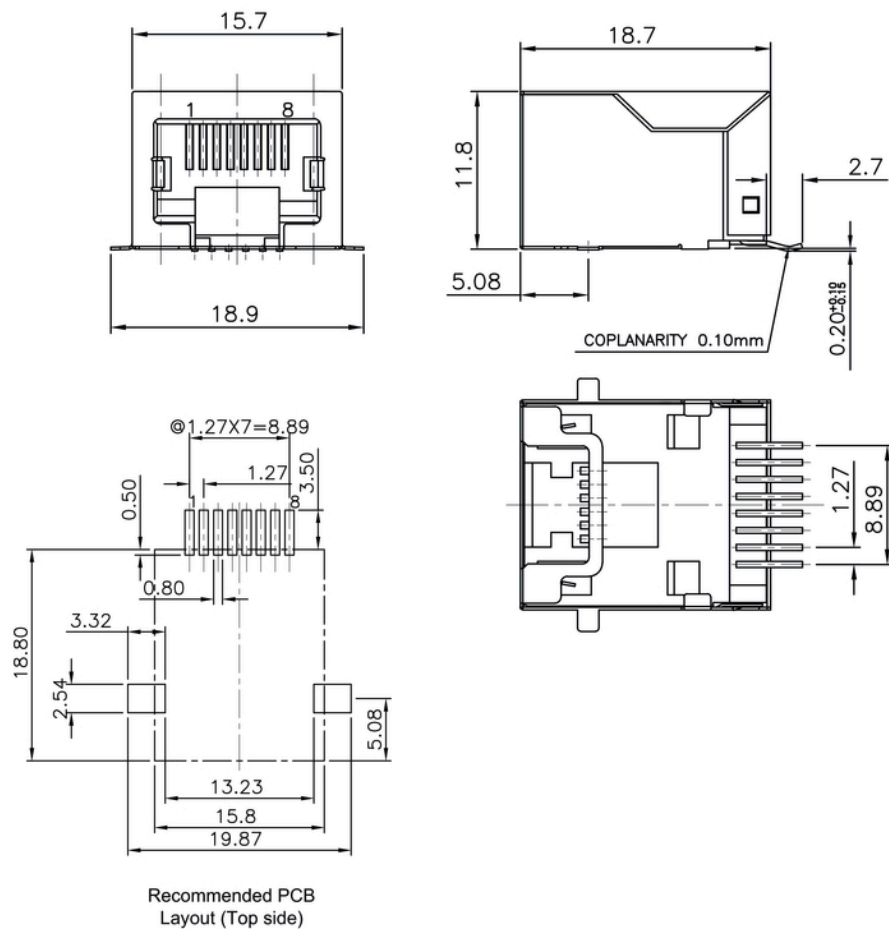
RJ45C5 S1D 2.7N4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßbild



RJ45C5 S1D 2.7N4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

RJ45	G1	R1	I1	U1	U2	E1	E4	GY/GY	TY
									Packaging TY LED Y/G G/Y G/Y GY/GY O/O R/O ... N Contact surface thickness 4 EMI tabs (ground fingers) E Solder Pin length 3.2 D 1.6 D Direction, latch style U D Horizontal (90°, side entry), latch up V Vertical (180°, top entry) Y Diagonal (45°), latch up Number of Ports 1 12; 14; ... multi ports side by side, Multiport 21; 41; ... multi ports about each other, Multilevel Assembly on PCB R Through Hole Reflow - THR S Soldering process: Wave or Reflow soldering Surface Mount Technology - BMT T Soldering process: Reflow soldering Through Hole Technology - THT Soldering process: Wave Performance Category C5 Category 5 C6 Category 6 C6A Category 6A C5e Category 5e M 10/100 Mbit G1 10/100/1000 Mbit G10 10 Gbit U Unshielded MP 10/100 Mbit with POE MP+ 10/100 Mbit with POE+

Legende

Erstellungs-Datum 4. Mai 2024 21:24:28 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

Empfohlenes Reflow-Lötprofil**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

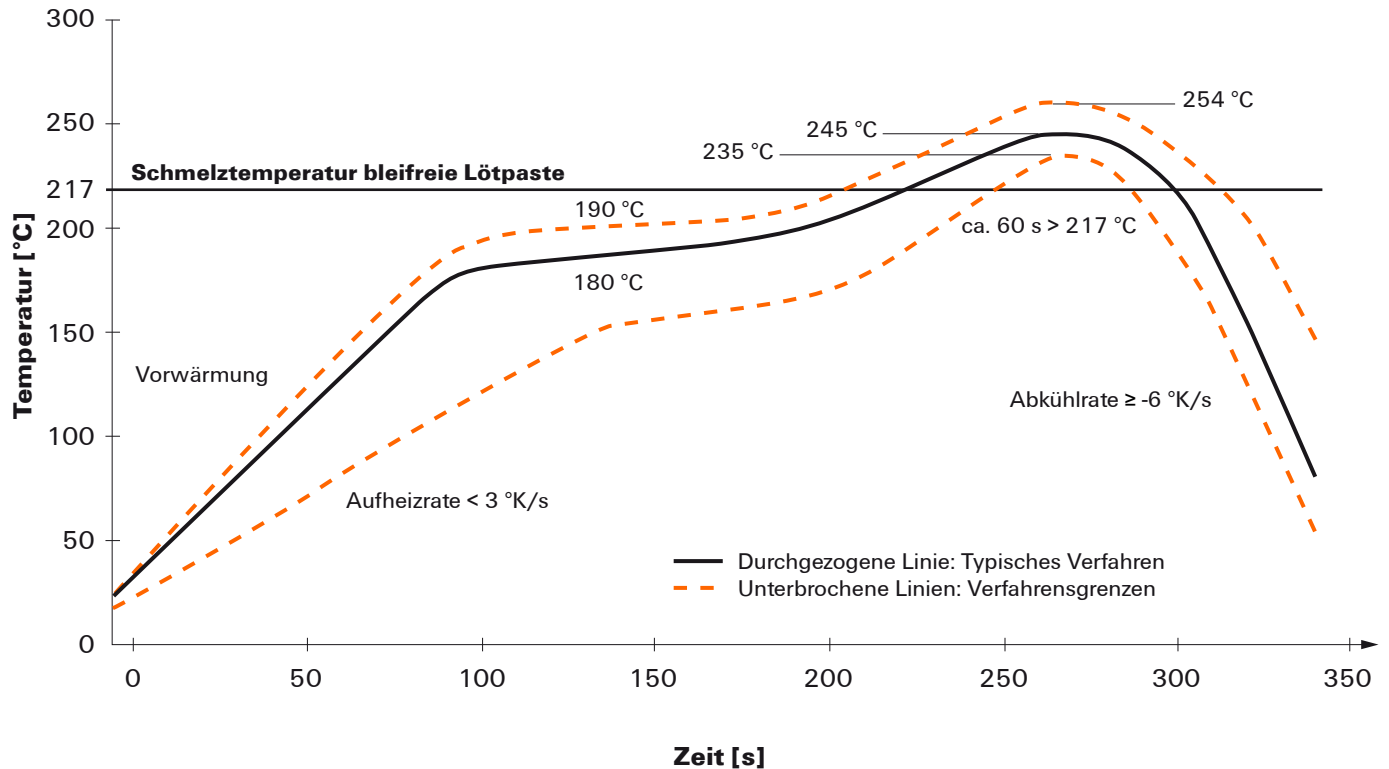
D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Reflow Lötprofil**

Das ideale Temperaturprofil für die Surface Mount Technology (SMT) ist eine häufig gestellte Frage in der Produktionswelt. Eine eindeutige Antwort gibt es nicht. Der Temperatur-Zeit-Verlauf ist abhängig von den Verarbeitungseigenschaften der Lotpaste und den Belastungsgrenzen der Bauelemente.

Folgende Parameter sind zu berücksichtigen:

- Vorheizzeit
- Maximale Temperatur
- Zeit oberhalb des Pasten-Schmelzpunktes
- Abkühlzeit
- maximaler Aufheizgradient
- minimaler Abkühlgradient

Das von uns empfohlene Lötprofil beschreibt den typischen Verlauf sowie die Prozessgrenzen. In der Vorheizphase werden Platine und Bauelemente schonend vorgeheizt. Der Aufheizgradient beträgt $\leq +3$ K/s. Parallel dazu wird die Lotpaste „aktiviert“. In der Zeit oberhalb der Schmelztemperatur 217 °C wird das Lot flüssig, verbindet die Bauelemente mit den Anschlüssen auf der Platine. Dabei wird die maximale Temperatur von 245 °C bis 254 °C zwischen 10 und 40 Sekunden gehalten. In der Abkühlzeit bei ≥ -6 K/s härtet das Lot aus. Platine und Bauelemente werden nicht zu rasch abgekühlt, um Spannungsrisse zu vermeiden.